Descrizione del prodotto

Finitura: questa scheda deve essere placcata in oro a immersione secondo IPC-6012. Spessore deve essere. 050uM oltre 3-6uM nichel.

Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, disseccante messo nel fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del layer

L1------Hoz
-PP 0.234 mm-L2------1
-COre 0.127 mmL3------1
--PP 0.234 mmL4--------Hoz

Produttore: HDI PCB stampato circuito di bordo, Circuito stampato Fornitore, Quick Turn

PCB stampato circuito di bordo







